



NEWS LETTER

Janvier 2018

MICROTEST

ZA la Garrigue du
Rameyron
84830 Sérignan du
Comtat - FRANCE

Téléphone

+33(0)4 9040 6090

Télécopie

+33(0)4 9040 6105

Adresse électronique

microtest@microtest-
semi.com

Web

www.microtest-
semi.com

SALONS

MICROTEST sera présent :

-Du **31 Janvier au 01 Février 2018**

Au salon IMAPS (International
Microelectronics Assembly and
Packaging Society) à La Rochelle,
FRANCE

Site : www.france.imapseurope.org

-Du **07 Février au 08 Février 2018**

Au salon ENOVA – Cité Centre des
Congrès à LYON
FRANCE

Site : <http://enova-event.com/>

-Du **28 Mars au 29 Mars 2018**

Au salon Mesures et Solutions –
Cité Centre de Congrès Lyon
France

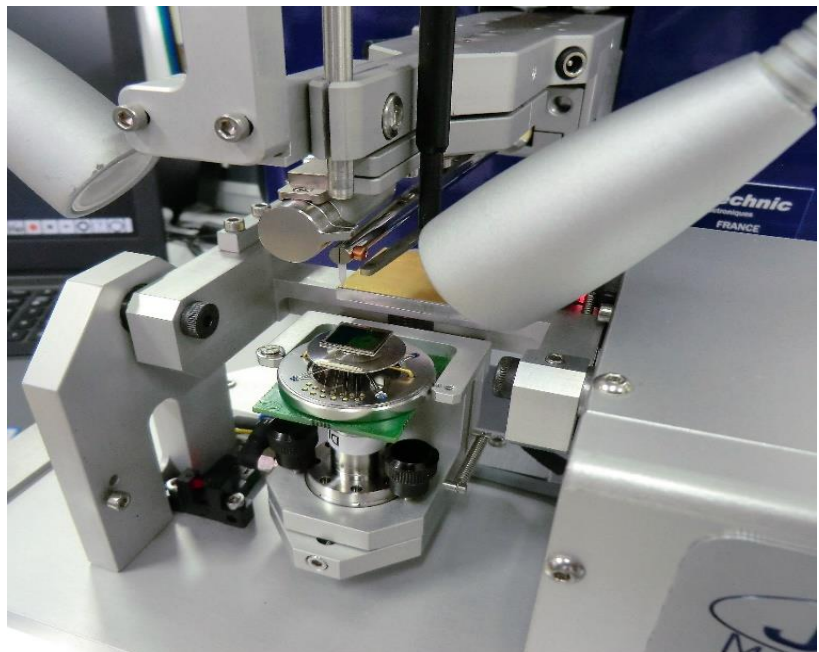
Site : [https://mesures-solutions-
expo.fr/](https://mesures-solutions-expo.fr/)

WIRE BONDER 200

INSTALLE A SAFRAN Electronics & Defense POITIERS

Qu'est-ce que le Wire Bonder 200 ?

Le Wire Bonder est un équipement manuel et semi-automatique de câblage filaire pour le wedge, ball avec secure Bump et ruban. Les 3 axes XYZ sont motorisés permettant, grâce à une caméra verticale focalisable sur différentes hauteurs, de réaliser des câblages dans n'importe quelles conditions (voir ci-dessous). La machine est compatible pour les bonding sur de très petites géométries et les applications microwave.



En quoi cet équipement est-il adapté à votre application ?

Cette application est spécifique à l'unité Module de Détection du centre de Poitiers. JFP a développé un outillage sur mesure par rapport à notre application. Le WB200 comprend un indexeur permettant de faire la première soudure sur un plan, l'outil remonte et l'indexeur effectue une rotation de 90°, l'outil redescend pour faire la 2nd soudure sur le deuxième plan. Avant d'avoir accès à cette application les liaisons par soudures se faisaient manuellement avec des risques de dégrader le composant infrarouge lors des manipulations. Le fait d'avoir actuellement cet outillage permet donc de réaliser ces câblages de manière automatique. Grâce à cet indexeur on obtient donc une liaison avec une bonne répétabilité de longueur et une qualité d'assemblage non dépendant opérateur.



Réalisé par Floriane
 MONTEIL, Assistante
 Marketing, suite à
 l'entretien avec :

PHILIPPE RASSINOUX
 EXPERT SAFRAN E&D



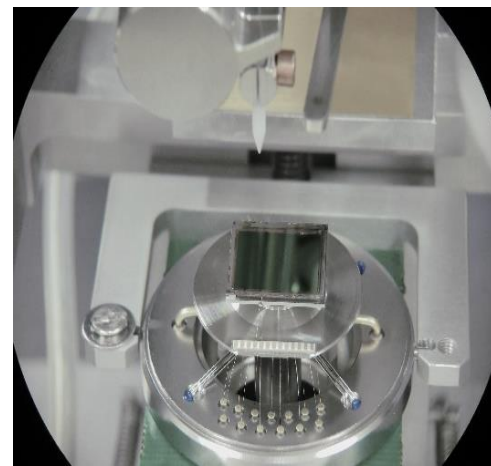
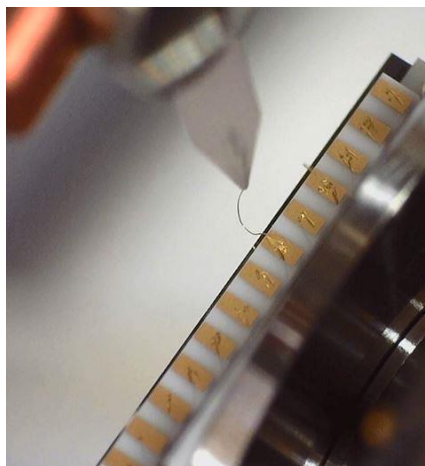
Domaine d'expertise
 Responsable Process :
 Unité Module De
 Détection Infrarouge

Safran Electronics &
 Defense Poitiers

26 avenue des Hauts de
 la Chaume
 BP 2086281 ST BENOIT
 FRANCE

Comment s'est déroulée l'installation du WB200 ?

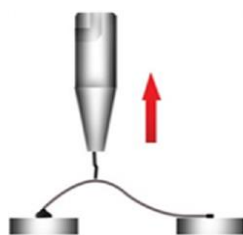
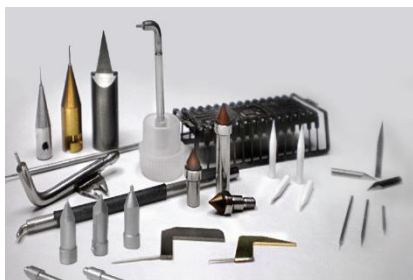
Je me suis rendu chez JFP-Microtechnic pour les tests de pré-acceptance et pour me former sur le fonctionnement de la machine. Concernant la livraison, nous avons reçu la machine sous caisse très bien emballée, le transport n'a pas causé de dommage. L'installation s'est très bien déroulée et la formation qui a suivi m'a tout de suite permis de me sentir bien en confiance avec le Wire Bonder WB200 et l'option sur mesure indexeur.



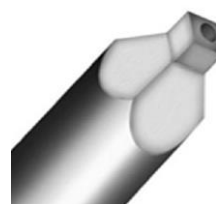
Parlez-nous de l'activité de votre unité sur le centre de Poitiers

Ma fonction au sein de Safran Electronics & Defense (anciennement Sagem) à Poitiers, est Responsable Process sur une unité de fabrication qui intègre des composants infrarouges dans des boîtiers cryogéniques. Je participe entre autres à la mise en œuvre de micro câblages, ces derniers assurant les connexions entre le composant infrarouge et la carte électronique connectée sur les sorties du cryostat. L'unité de fabrication sur Poitiers assemble des systèmes infrarouges destinés à la vision nocturne.

MICROTEST vous propose également une large gamme de consommables pour vos outils de bonding : die collets, rubbers, aiguilles d'éjection, outils etc. Pour vos process de câblage, nous proposons des outils pour les machines de pull test et de shear. N'hésitez pas à nous communiquer vos besoins afin que nous les étudions ensemble vers les meilleures solutions qualité à prix compétitifs (voir site web www.microtest-semi.com)



Wire Pull



Die collet



Ball Shear